

(2)2006年活動実績データ

①提案規格数 新規41件、改正1件

TC	SC	WG	規格名称	新規・改正の別
40			Packing of components for automatic handling – Part 3: Type VI: Packing of surface mount components on blister carrier tapes 4 mm in width	
40			Low ESL measuring method on capacitors with lead terminal for use in electrical and electronic equipment	
40			Low ESL measuring method of surface mount capacitors for use in electrical and electronic equipment	
47		4	Semiconductor devices – Micro-electromechanical devices – Part 6: Axial fatigue testing methods of thin film materials	
47		5	47/1892/NP – Future IEC 62374-1 Time Dependent Dielectric Breakdown Test (TDDB) for Inter-metal layers	
47	A	2	Family specification – Low voltage integrated circuits: 低電圧ICファミリ規格	
47	D	1	Dimensions of semiconductor devices (Discrete semiconductor devices)	
47	D	2	IEC 60191-6-14:Measuring methods for package dimensions of small outline J-lead packages (SOJ)	
47	D	2	IEC 60191-6-17:Design Guide for Stacked Packages and Individual Stackable packages – Fine-pitch Ball Grid Array and Fine-pitch Land Grid Array Packages (FBGA/FLGA)	
47	D	2	Design guide for ball grid array (BGA)	
47	D	2	IEC 60191-6:General rules for the preparation of outline drawings of surface mounted semiconductor device packages	
47	E	2	47E/312/NP Microwave integrated circuits – Oscillators	
48	B	3	IEC 60352-8 Ed.1.0: Solderless connections – Part 8: Compression mount connections – General requirements, test methods and practical guidance	▲
48	D	4	Dimensions and test method of general use 1U unit-case (Pizza-box) for electronic system, based on IEC 60297 series	
49		10	SAW duplexers – Part 2: Guide to the use	
51		9	DC/DC コンバータ用インダクタの定格電流値の決め方	
51		1	PQ形フェライト磁心の寸法規格	
56		3	Management of Reviews in a Product's Life Cycle	
86		JWG9	62496-1 Optical circuit boards – Part 1: General specification	
86	B	6	61754-25 Fibre optic connector interfaces – Part 25: Type RAO connector family	
86	B	6	61754-26 Fibre optic connector interfaces – Part 26: Type SF connector family	
86	C	4	Transmitter components with LC connectors without thermo-electric coolers	
86	C	4	Transmitter components with LC connectors and thermo-electric coolers	
86	C	4	Receiver components with LC connectors and PIN or avalanche photodiodes	
86	C	4	Receiver components with LC connectors and avalanche photodiodes	
86	C	5	Dynamic gain equalizer – Response time measurement	
91			Performance guide for single- and double-sided flexible printed wiring boards	
91			Clad Laminate for Flexible Printed Wiring Boards (Adhesive and Non-adhesive types)	
91		3	Surface mounting technology – Environmental and endurance test methods for surface mount solder joints – Part 5: Mechanical shear fatigue test (Intended to become IEC 62137-1-5, if approved)	
91		3	Surface mounting technology – Environmental and endurance test methods for surface mount solder joints – Part 4: Cyclic bending test (Intended to become IEC 62137-1-4, if approved)	
91		3	Evaluation criteria for voids in soldered joint of BGA	
100	4		60958-1: Digital Audio Interface – Part 1: General	
100			60268-7: Sound system equipment – Part 7: Headphones and earphones	
100	9		62480: Multimedia Home Network – Network Interfaces for Network Adapter	
100	5		60728-13: Cable networks for television signals, sound signals and interactive services – Part 13: Optical transmission systems	
100			62503: Multimedia quality – Method of assessment of synchronization of audio and video	
100			62503: Multimedia quality ? Method of assessment of synchronization of audio and video	
100	5		60728-13: Cable networks for television signals, sound signals and interactive services – Part 13: Optical transmission systems	
100	10		Multimedia systems and equipment – Multimedia e-publishing and e-books – Reader's format	
103			Methods of measurement for digital network – Performance characteristics of digital terrestrial television transmission network (NPPAS)	

注)改正は▲印

②国際会議実績

a)参加実績 ○回延べ638人

b)日本での開催実績

TC	SC	WG	名称	開催地	開催期間
40			MT(60115-1/-8)会議	東京	8月23～25日
47		2	TC91/WG3とのJWG		5月、10月
76			TC国際会議	長崎	12月11～15日
93		JWG1	JWG	日本	
94			TC国際会議・MT3・WG10	東京	3月
100	TA1		PT62487会合	東京	12月11～12日
108			HBSDT国際会議	京都	3月20日～24日
110			TCプレナリー & WG	大津	12月5日
110		2	WG	東京	10月
		5	WG	東京	2月

③幹事国・議長等引受実績

TC	SC	WG	幹事・議長・主査の別
IEC			
39		3	主査(電気硝子工業会 勝田忠男氏)
47		4	主査(帝京大学 大和田邦樹氏)
	A		幹事(NECエレクトロニクス 春日壽夫氏)
		2	主査(日立製作所 三谷真一郎氏)
		7	主査(NECエレクトロニクス 春日壽夫氏)
	D		議長(ユニテクノ 中村伸一氏)
		2	主査(東芝 大野淳一氏)
47	E		議長(帝京大学 大和田邦樹氏)
		2	主査(ソニー 大芝克幸氏)
		3	主査(日立製作所 古賀健司氏)
		4	主査(シャープ 増田敏幸氏)
49			幹事(元玉川大学教授 児島俊弘氏)
		4	主査(村田製作所 戸川一也氏)
		6	主査(日本電波工業 小山光明氏)
		9	主査(日本電波工業 小山光明氏)
		10	主査(日本電波工業 山本泰司氏)
51			幹事(TDK 三井正氏)
		10	主査(NECトキン 吉田栄吉氏)
76	AAG		議長(光産業振興協会 増田岳夫氏)
86	JWG9		主査(白山製作所 杉田悦治氏)
	B		幹事(白山製作所 杉田悦治氏)
	C	3	主査(コーニングインターナショナル 岡村治男氏)
		4	主査(千歳科学技術大学 吉田淳一氏)
91			幹事(ソニー 西山和夫氏)
		3	幹事(NECエレクトロニクス 春日壽夫氏)
		5	主査(日本電子回路工業会 柴田明一氏)
		10	主査(日本電子回路工業会 柴田明一氏)
93			議長(SRIインターナショナル 唐津治夢氏)
		2	主査(小島智氏)
		6	主査(日立製作所 高橋満氏)
		7	主査(SRIインターナショナル 唐津治夢氏)
94		10	主査(安川コントロール 浜田健次郎氏)
100			幹事(東芝 平川秀治氏)
	TA1		幹事(東芝 伊賀弘幸氏)
	TA2		議長(千葉大学 池田宏明氏)
	TA6		議長(松下電器産業 野谷正明氏)、幹事(ソニー 向井幹雄氏)
	TA7		議長(東北大学 村岡宏明氏)、幹事(ソニー 向井幹雄氏)
	TA8		議長(富士通 松村秀一氏)、幹事(富士通研究所 本多文雄氏)
	TA9		幹事(松下電器産業 南典政氏)
	TA10		議長(東京電機大学 植村八潮氏)、幹事(ソニー 向井幹雄氏)
110			議長(電気通信大学 御子柴茂生氏)、幹事(希美電子 岩間英雄氏)
		2	主査(シャープ 石黒勝己氏)
		4	主査(広島大学 篠田傳氏)
ISO			
42		18	主査(キャノン 永田徹氏)
172	9	7	主査(立命館大学 小野雄三氏)

提案年月
2006.2
2006.3
2006.12
2006.5
2006.9
2006.2
2007.2
2006.11
2006.4
2006.1
2007.2
2006.09
2006.9
2006.2
2007.2
2006.6
2006.10
2007.2
2006.6
2006.6
2006.6
2006.8
2006.8
2006.8
2006.8
2006.6
2006.7
2006.7
2006.9
2006.9
2006.9
2006.3
2006.3
2006.4
2006.7
2006.8
2006.8
2006.6
2007.2
2006.1

